证券代码：301348　　证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　　☐分析师会议 ☐媒体采访　　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　　☐路演活动 ☑现场参观 ☐其他（电话会议）
参与单位名称/人员姓名	银河证券、东莞证券、维度（佛山）创业投资有限公司、广东仟贝私募基金管理有限公司、广东万泽汇资产管理有限公司、亚欧国际教育、深圳市煜创投资管理中心（有限合伙）、佛山市厚磐传承管理咨询有限公司、北京天襄资本管理有限公司、个人投资者等
时间	2026年06月17日 14:30-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张国光；证券事务代表：林品旺
投资者关系活动主要内容介绍	**一、 参观公司生产线及募投项目** **二、 公司董事会秘书张国光先生介绍公司基本情况** **三、 互动交流环节** **1. 2025 年营收、归母净利润同比变化？净利润亏损的主要原因？** 回复：2025 年实现营业收入 7.12 亿元，同比下降 0.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,737.11 万元，同比下降 347.30%。主要原因：一是下游消费电子行业需求偏弱，市场整体需求不及预期；二是行业市场竞争加剧，产品销售价格承压；三是部分原材料价格、人力成本有所上涨，综合导致公司盈利水平下滑。 **2.公司产品结构调整方向？** 回复：公司目前正重点向工业、新能源汽车领域和车规级产品的应用市场进行推广。依托“自有品牌+封测服务”双轮驱动模式，重点突破电源 IC、高端功率器件等工艺瓶颈，提升产品附加值。 公司持续强化功率器件、宽禁带功率半导体器件、Clip bond、LQFP 及 BGA 封装工艺、车规级产品、存储芯片封装等领域的研发创新能力；加大晶圆级芯片封装、系统级封装（SIP）投入，在现有 SIP 技术基础上，进一步拓宽封测服务技术边界与产品种类，实现模拟电路、数字电路、传感器、存储芯片等多领域封测能力全覆盖，巩固并提升核心技术壁垒。 **3.公司收购成都芯翼后，如何发挥协同效应？** 回复：成都芯翼是一家专注于高可靠模拟集成电路研发、生产及销售的国家级专精特新“小巨人”企业，已被认定为国家级高新技术企业、四川省瞪羚企业，并获授予成都市企业技术中心称号。标的公司构建了覆盖芯片设计、流片管理、产品测试及应用支持的全流程研发和产业化体系，产品主要聚焦于计算机处理、感知与导控、雷达通信对抗等三大应用场景，重点研发产品包括通信接口芯片，模拟信号链芯片等，其产品性能符合高可靠质量体系标准，满足客户自主可控需求。 本次交易完成后，成都芯翼将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

	本次交易的协同价值将围绕业务、技术、供应链三个维度落地： 业务协同：双向赋能形成闭环，成都芯翼的芯片产品可优先对接公司封装测试产能，保障交付稳定性与成本优势；公司也可依托标的公司的设计能力，拓展新的客户及单客户价值。 技术协同：封装技术与芯片设计前置联动，在芯片设计阶段就匹配最优封装方案，联合研发高集成度、高可靠性的定制化封装产品，缩短新产品迭代周期，共同提升技术壁垒。 供应链协同：双方统筹核心原材料采购、产能调度，通过规模效应降低采购成本，提升整体供应链抗波动能力。 **4.关于公司参股深圳芯展速的战略价值与协同** 回复：公司对芯展速的投资，是结合芯展速在半导体高性能企业级存储主控芯片、企业级 SSD 产品、数据服务领域等优势和公司在封装测试领域的技术与制造能力，有助于公司拓展新的应用场景、丰富产业生态。此次投资是基于半导体产业链协同发展作出的审慎布局，符合公司长期发展方向，有利于提升综合竞争力与抗风险能力。 **5.关于公司产能、产能利用率情况，产能扩张优先满足哪些领域？** 回复：公司具备覆盖 4 英寸-12 英寸晶圆全流程封测能力，公司募投半导体封装测试扩建项目已投入使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司产能达到 220 亿只/年的生产规模，产能利用率处于长期温和放量的态势。 公司结合多年技术积淀，持续投入研发，依托募投项目研发中心支撑，重点推进功率器件工艺升级和产品迭代、转型，同步开展存储芯片封装工艺的储备与积累，稳步推动存储相关产品产业化落地，为年度收入增长与效益提升提供核心支撑。 同时，公司正推动产品结构升级，深耕主营业务，重点向工业、新能源汽车领域和车规级产品的应用市场进行推广。 **6.行业竞争情况与公司产品定价策略** 回复：公司当前处于完全竞争的市场环境，市场化定价策略已成为行业竞争的主要方式。 公司计划持续优化产品结构，加大高附加值、高壁垒产品研发量产，以技术创新提升定价话语权；深化供应链精细化管理，与核心上下游建立长期战略合作，平抑成本与价格波动；建立市场研判与动态响应机制，灵活调整产能、库存及价格策略；拓展新能源汽车、储能、工业控制等高增长领域，降低单一市场依赖；强化内部降本增效，提升核心客户粘性与商务议价能力，稳固盈利水平。 **7.公司研发投入与研发方向** 回复：公司 2025 年研发投入占营收比例为 4.19%。公司持续强化在功率器件、宽禁带功率半导体器件、Clip bond、LQFP 及 BGA 封装工艺、车规级产品、存储芯片封装等领域的研发创新能力；加大晶圆级芯片封装、系统级封装（SIP）投入，在现有 SIP 技术基础上，进一步拓宽封测服务技术边界与产品种类，实现模拟电路、数字电路、传感器、存储芯片等多领域封测能力全覆盖。
附件清单（如有）	无
日期	2026年06月17日